

电子信息制造业发展“十五五”规划

电子信息制造业规模大、链条长、创新活跃，市场化、国际化程度高，赋能引领作用显著，是国民经济的支柱产业、实现新型工业化的重要力量。为推进电子信息制造业提质升级，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，制定本规划。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定基本实现新型工业化目标，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，抢抓人工智能发展机遇，筑牢人工智能根基，加快电子信息制造业全产业链创新，推动科技创新和产业创新深度融合，强化新技术、新产品融合应用赋能，推进产业开放合作，提高产业治理现代化水平，为建设制造强国和网络强国奠定坚实基础。

到 2030 年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破 30 万亿元。产业链安全水平显著提升，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批

长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。产业创新效能明显提升，研发投入强度达到 3.5%，重点领域关键核心技术快速突破，领跑、并跑领域明显增多，算力供给能力大幅增长，新一代智能终端应用普及率显著提升。产业生态更趋完善，硬件、软件、标准、专利协同取得新进展，区域布局和国际合作取得新成效。智能化、绿色化、融合化发展水平提高，为保障国民经济和社会发展安全、提升人民物质文化生活水平提供有力支撑。

二、重点任务

（一）筑牢产业基础能力

1.推动集成电路全链条攻关。发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟和数模混合芯片等高端芯片产品。提升集成电路制造水平，做精做细成熟制程，提高先进制程能力。推动先进封装测试技术开发和应用。推动宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。持续提升关键装备、材料和零部件供给能力，加快发展电子设计自动化工具（EDA）和知识产权核（IP 核），推进三维集成等技术突破和应用。

2.促进电子元件和电子材料高端化发展。推动电子元件与电子材料产业协同发展，面向人工智能、新一代信息通信、航空航天、新一代智能终端等重点领域需求，加快攻关一批成熟可靠、广泛适用的产业基础“货架产品”，支持电路类、连接类、机电类、传感类、功能材料类等电子元器

件向高频高速、高集成、高可靠等方向发展，推动高性能电子功能材料、封装与装联材料、工艺与辅助材料突破，提升电子元器件和电子材料产品质量稳定性、可靠性和一致性水平，更好保障整机和系统发展需求。围绕制造业重点产业链，搭建上下游对接平台。支持建设电子元器件、电子材料等中试平台和应用验证中心，助力产品创新升级。发挥电子材料国际交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心交易对接作用，大力发展电子分销行业，提升供应链抗风险能力。

专栏 1 电子元器件及电子材料高端化跃升

- 1.电路类元器件。发展微型化、片式化、高可靠阻容感元件，高频率、高精度频率元器件，小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件等。
- 2.连接类元器件。发展高频高速、低损耗光电连接器，超高速、超低损耗光纤光缆，高频高速、高层高密度印刷电路板，集成电路（IC）载板等。
- 3.机电类元器件。发展高压、大电流、小型化、低功耗控制继电器，小型化、集成化、高精密、高效节能微特电机等。
- 4.传感类元器件。发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等高端传感器，微型化、智能化电声器件等。
- 5.功能材料类元器件。发展高磁能积、高矫顽力永磁元件，高磁导率、低磁损耗软磁元件，高导热、电绝缘、低损耗、无铅环保电子陶瓷元件等。
- 6.电子功能材料。发展大尺寸晶片等半导体材料，低成本高性能磁性材料，高可靠电子陶瓷材料，超小尺寸压电晶体材料，高容量、高性能电池材料等。
- 7.封装与装联材料。发展高频高速覆铜板材料，低轮廓铜箔，高性能通讯射频基板等封装基板，高可靠性合金锡膏等锡焊料，高性能芯片粘接薄膜（DAF）、导电胶等粘结材料，高性能电子纱/布，高导热热界面材料。
- 8.工艺与辅助材料。发展先进工艺用湿化学品，高性能电子树脂金属及其氧化物/氮化物靶材，超纯微纳米铜粉及浆料，高纯石墨/石英制品，电磁屏蔽材料、密封与绝缘材料等。

3.加快智能传感器创新与应用。提升微机电系统（MEMS）等智能传感器工艺能力，支持传感器可靠性技术

开发。健全智能传感器设计、制造、封测等全流程质量管控机制，加快提升产品稳定性、一致性。推动一批主流智能传感器产品向高端迈进，提升谱系化供给能力和系统级应用能力，增强高端产品市场竞争力，推动智能传感器在重点行业和场景的融合应用。

4.提升电子专用设备及测量仪器供给能力。实施电子专用设备攻坚计划，推进电子专用设备、测量仪器整机及配套系统攻关。聚焦载板大尺寸、三维立体集成、异质异构集成、微缩等方向开展生产设备研发，积极布局高带宽、太赫兹、量子精密测量等电子测量仪器前沿技术，促进各细分领域生产设备融通发展，带动关键元器件突破。发挥首台（套）保险补偿机制、政府采购等作用，推进攻关产品的应用推广，多渠道扩大国产电子专用设备和测量仪器使用。大力发展设备维保能力，畅通零部件及元器件交易渠道，加快发展设备服务业。

专栏 2 电子专用设备及测量仪器自主保障水平提升
1.材料制备设备。支持金属有机化合物气相沉积、真空低温干燥、大尺寸晶体生长、分子束外延、超薄流延、超高层叠层等设备研发。 2.电学性能生成设备。加强电子束曝光、激光直写、纳米压印、激光钻孔、原子层刻蚀、等离子体增强化学气相沉积、原子层沉积、精密电镀、垂直蒸镀等设备攻关突破。 3.封装组装设备。发展巨量转移、纳米级光耦合、亚微米级高精度贴装、低温共晶焊、微转印等设备。 4.量检测设备。开发电致及光致发光、残余气体分析仪、自动光学检测、光学关键尺寸量测、椭偏仪、台阶仪等设备。 5.电子测量仪器。攻关宽带矢量网络分析仪、宽带矢量网络信号发生器、宽

带数字示波器、低底噪宽带频谱分析仪、超高速网络性能测试仪、多信道测试接收机、太赫兹测试仪等设备。

5.夯实光子产业发展根基。推动光子产业核心环节技术取得突破，支持光子设计自动化、光电协同设计自动化等仿真设计软件研发迭代，建设微纳加工制造、光电融合集成等共性工艺平台，布局光子功能材料、工艺材料研发创新，强化光产生、光处理、光传感、集成光芯片和微纳光学元件供给，开展光收发模块与引擎、光处理模块、激光雷达和陀螺仪、配套电芯片器件的研发与产业化。围绕光子产业关键领域和共性需求布局中试验证平台，推动成果验证、工艺优化、设备选型、技术集成，加速新产品研发和产业化应用。推动光子技术向人工智能、新型通信、泛在终端、工业制造、医疗健康、高端制造、城市安防等重点领域渗透。

专栏 3 光子关键技术和产品研发

1.微纳加工制造工艺平台。推动 6 英寸及以上化合物半导体、8 英寸及以上光微机电系统、12 英寸及以上微纳光学超结构表面等制造工艺平台建设。

2.光电融合集成工艺平台。重点提升 8 英寸及以上硅基光电子低成本规模量产和多材料体系异质集成能力，突破 12 英寸先进制程的多维异构集成关键技术，推动光电融合集成平台建设。

3.光芯片与器件。重点发展大带宽、窄线宽、高功率激光器，高功率太赫兹光源，光通信用高速互补金属氧化物半导体（CMOS）异构集成微发光二极管阵列器件，超快激光器、多端口光电路交换器件、高维度波长选择开关、多波段一体化光放大器、大带宽探测器、单光子探测器、光纤传感器、红外紫外及太赫兹探测器、超快三代像增强器、光电共封装芯片。

4.微纳光学元件。重点发展微纳光学超结构表面元件、高面型精度透镜/棱镜、精密薄膜、精密光栅、低精度误差法拉第旋光片、高性能光波导器件。

（二）增强电子整机与系统竞争力

6.提升重点领域产业链韧性。推动重点产业链补链，加快强化产业生态主导权。培育一批关键产业链，开展产业链成熟度评估。打造一批制造业单项冠军企业，加强专精特新中小企业培育，持续提升产业链供应链核心竞争力。

7.构筑先进计算生态体系。加快计算架构、数据存储、高速互连、软硬协同、算电协同等先进计算产品及技术创新攻关，推动设立先进计算国家科技重大项目，持续提升计算根技术、关键元器件、核心零部件、软件算法、计算设备等供给水平。满足海量化、多元化智能计算等需求，构建异构协同计算体系，开发面向人工智能大模型训练及推理的计算微架构，突破分布式计算、高带宽内存池、云边端协同、全光交换、液冷散热等关键技术。加强算力、存力、运力、电力等要素协同和融合创新，加快存算一体、量子计算、光计算、类脑计算、太空计算等新计算范式布局，推动智能计算、通用计算、超级计算等融合发展。健全计算标准体系，强化服务平台建设，推进先进计算在新一代智能制造、信息消费、社会治理等领域广泛应用，完善先进计算协同创新生态。

专栏 4 先进计算产业系统化提升

1.处理器与关键部件。提升多类型处理器微架构设计能力，提高计算芯片性能水平。突破行业共性技术难点堵点，研发互连、电源等配套芯片模组。

2.存储技术与产品。加快发展先进存力，推动以存强算、以存代算，提升分布式、超融合等存储系统的技术水平，完善分级分层数据存储架构及存储协议。突破智能分层存储、数据稀疏化优化、键值缓存等技术，研发高带宽闪存、高带宽内存、铁电存储器、阻变存储器、磁电存储器等新型存储产品。

3.计算设备与系统。研发基于异构计算架构的新一代计算设备，优化本地人

工智能大模型软硬件支持能力。研发面向高端通用、高可靠存储、人工智能训练推理、云边协同等场景的计算设备系统，提升新型工作站、嵌入式计算系统、端侧计算设备等供给能力。

4.设施与应用。突破超大规模智算设施架构设计，支持数十万卡级人工智能集群。加快太空计算全链条布局，推动算电协同深度耦合创新。攻关分布式边缘计算架构，加强高性能编译器、数据库及中间件等应用。突破专用加速器与大规模并行计算瓶颈，提升 Z 级超算性能。

8.加快消费电子创新发展。加大终端产品供给，加强产品工业设计，持续推动手机、个人计算机、视听电子、虚拟现实（含增强现实、混合现实）、可穿戴设备、服务类新型终端等消费电子产品智能化、融合化升级。布局空间计算、显示光学、感知交互、内容制作、传输编码等关键技术。强化产业链协同，提升关键部件、软件工具、终端外设、场景应用等全链条供给能力与协同发展水平。推动“视听友好”工作，发展护眼护耳产品，提升电子产品用户体验。推进消费电子适老化改造，发展智慧健康养老产业。面向文旅、住建、教育、医疗、养老、体育等重点领域，加快推动消费电子产品创新和应用落地，开展典型案例征集和应用推广活动。

专栏 5 消费电子重点产品创新

1.高端手机。突破核心芯片、高端显示器件等关键环节。支持新形态产品研发和差异化竞争。

2.个人计算机。突破高性能芯片，发展主板架构设计与印制电路板（PCB）高密度集成技术。强化柔性显示、先进封装等技术应用，加速产品形态创新。

3.视听电子。突破高端音视频处理芯片、显示模组、音频模组等关键部件，推动电视机、投影机、平板电脑、音响、耳机等重点产品升级。发展内容制作设备和软件工具，推广轻量化、智能化超高清音视频制播系统。

4.虚拟现实。布局近眼显示、多模态感知交互、空间智能体等关键技术，研

发低功耗专用芯片、高性能微显示和光学器件，发展多形态终端产品。

5.可穿戴设备。突破低功耗处理器、精密传感器、柔性电子器件、类基板印制电路板，发展轻量化操作系统，丰富手表、手环、戒指等多形态产品供给。

6.服务类新型终端。加快推动智慧家庭产品智能化跃升与互联互通，丰富智慧健康养老产品及服务供给，挖掘细分市场，提升场景适配能力。

9.推进软硬协同和电子系统设备突破。构建安全可靠、先进泛在的新一代信息技术体系，加快硬件能力先行，全面提升电子信息产品系统性能。强化开源开放与协同共建，加强开源鸿蒙等国产操作系统搭载，打造基于计算的人工智能软硬件全栈生态，健全配套软硬件协同适配工具。推进第五代精简指令集（RISC-V）研发与产业化，支持 RISC-V 芯片在人工智能、嵌入式系统等领域应用。深化芯模协同创新，加强算法与硬件架构协同设计优化。巩固通信设备竞争优势，加快高端数据通信、光通信、移动通信、卫星通信、新一代无线短距通信等技术和产品攻关。推动工控设备智能化升级，构建算控感传一体化工业计算体系。推动激光设备高端化发展及应用，突破高性能激光器、超精密激光加工、精密光机系统等技术。引导雷达设备数字化集成化智能化发展，加快智能驾驶、低空经济等新兴领域应用。加快移载设备技术攻关，提升柔性化智能化水平，面向新一代智能制造等需求扩大应用。

（三）培育产业发展新增长点

10.巩固能源电子产业优势。持续推进“光、储、端、信”等能源电子技术协同发展。进一步推进高效晶体硅光伏电池

技术迭代升级，开发钙钛矿叠层电池等新一代高效光伏电池技术及配套设备材料，研发推广高可靠、智能化光伏组件和光伏系统智能运维技术，拓展“光伏+”应用场景。提升新型电池全产业链创新能力，巩固锂电池竞争优势，持续推进固态电池、钠电池、液流电池、燃料电池等产业化，推动新型电池智能化、绿色化、融合化发展，支持新型电池在智能终端、新能源汽车、船舶、航空、智能机器人、工程机械、农机装备等场景应用。加快电力电子关键技术研发供给，提高关键核心器件与部件供给能力，提升储能系统高效集成和精准调控水平。

专栏 6 能源电子产业化提升
1.光伏。突破钙钛矿叠层电池等先进光伏技术，加快产业化应用。开发低能耗、高纯多晶硅技术，大尺寸、超薄硅片技术，高可靠组件封装技术和智能光伏组件产品，推动逆变器、控制器、跟踪系统等关键部件智能化升级。大力支持钙钛矿材料、聚烯烃弹性体、高纯石英砂等光伏材料研发应用。拓展太空光伏、海上光伏等智能应用场景，培育光伏制氢氨醇等新模式新业态，推动光伏融合发展。 2.新型电池。开发高电压高稳定大容量正极材料、高容量低膨胀硅碳负极材料、高稳定高离子电导固体电解质、复合集流体等关键材料，强化高安全锂电池、高比能固态电池、低成本长寿命钠电池研发与产业化。 3.电力电子。发展先进功率半导体、智能传感器、电源管理等芯片、大功率高效变流器等电力电子产品，探索基于端边云架构的先进储能系统高效高精度管理技术和相变材料冷却、热管冷却、热泵等高效热管理技术，发展结构优化、多域融合、安全高效系统集成技术。

11.促进时空信息产业发展。纵深推进北斗规模化应用，推动北斗从行业应用转向全民普及。支持北斗芯片、算法、抗干扰、星地融合等技术攻关，破解“卡脖子”短板，构建全链条技术供给体系。立足国家综合定位导航授时（PNT）

体系建设，促进北斗导航、卫星互联网、空间遥感等协同融合发展，打通芯片、天线、终端、系统、服务全产业链，深化时空信息技术与实体经济各领域融合落地。前瞻布局卫星互联网，拓展直连卫星终端应用场景，完善终端产业生态。

专栏 7 时空信息技术研发与应用
1.北斗规模应用。加快赋能交通、农业、能源、应急、文旅等重点行业发展，培育大众消费领域应用新产品新模式新业态，拓展低空经济、自动驾驶、智慧健康养老等新兴场景创新应用。深化工业和信息化领域北斗规模应用城市试点培育，加快模式创新、场景落地和经验转化，支持北斗规模应用从局部实践向全域推广。 2.核心关键技术。攻克室内外无缝定位、低轨卫星增强、低成本相控阵天线、通导遥融合算法等技术，提升复杂环境定位精度和可用性。建立民用导航产品抗干扰分级分类标准，加快低成本、低功耗、小型化抗干扰产品研发，提升时空信息产品安全防护能力。 3.卫星互联网。面向天地一体化发展，加强直连卫星终端关键技术攻关，突破天地融合网络、星地多模收发等技术，推动终端向轻量化、低功耗、低成本演进。拓展手机直连卫星等创新应用，加快卫星互联网规模应用推广。

12.夯实人工智能硬件底座。支持技术攻关创新和产品迭代升级。加强人工智能芯片与整机产品协同，加快云端训练设备开发，面向具身智能、自动驾驶等领域开发端侧推理设备及芯片，巩固扩大人工智能芯片应用规模。推动计算高速互连总线统一协议（CLink）系列规范编制实施。强化人工智能芯片与大模型、数据库等适配。建设有关公共服务平台，健全人工智能芯片标准体系。持续推动人工智能手机、个人计算机、智能眼镜、视听终端、车载终端、工业终端、商业终端等产品迭代升级，拓宽使用场景，优化产品体验。强化端侧关键技术攻关，推动创新成果应用转化。加强端侧大模

型、计算芯片、存储芯片、操作系统兼容适配，加快智能体与终端产品深度融合。建立人工智能终端智能化分级标准体系和评估体系，加强标准实施推广。加快构建产业链上下游生态，支持人工智能终端在重点领域的规模化应用。

专栏 8 人工智能芯片和终端关键技术系统化突破

- 1.人工智能芯片。提升人工智能芯片设计水平，加强张量核心数据流组织、混合精度、动态稀疏计算、统一内存架构等技术攻关创新。聚焦低延迟、高吞吐、低功耗等核心性能指标，提高通用图形处理器（GPGPU）、专用集成电路（ASIC）、SoC 等处理器综合计算能力，布局软硬耦合推理芯片等新路线。
- 2.人工智能设备。面向差异化场景实施系统工程，推动开发多元异构智算系统、云端训练设备、端侧推理设备、嵌入式实时响应计算设备、大模型一体机、训推一体机等新产品。
- 3.人工智能芯片标准。推广《计算高速互连总线统一协议 总则》《计算高速互连总线统一协议 加速器互连技术要求》等系列标准，推动研制支持 CLink 的交换芯片、高速光模块等，培育人工智能底座生态。围绕异构适配、编译器统一接口、兼容性、安全性、可靠性等方面加强人工智能芯片相关标准供给。
- 4.端侧智能计算。攻关端侧智能计算芯片、高端存储芯片，开发近存计算、存算一体等新型架构。研发端侧操作系统和芯片使能软件，完善开发框架、算子库、推理加速引擎等开发环境。
- 5.端侧大模型和智能体。研发算法架构和轻量化技术，发展智能体技术，研究多模型调度、多智能体协作体系。研发高动态、高实时姿态和运动控制技术，开发具身智能算法库、动作库、知识库。
- 6.端云协同和跨端协同。研究模型部署、智能调度等技术。攻关端云互通组件、协议、数据压缩传输和通讯网络优化等环节。
- 7.多模态自然交互。研究视觉、听觉、触觉、运动、位置等高精度智能传感与多模态融合算法，研发环境建模、行为规划等感知与决策技术。优化多模态交互系统对话和反馈能力，强化跨应用、跨系统、跨终端交互协作。
- 8.全链路安全。研发面向端侧大模型的安全芯片、安全启动、可信运行环境、数据溯源等技术，研究数据加密、身份验证和授权、隐私保护等安全算法。

13.加快行业电子数智技术创新融合。面向国民经济主战场，加快电子信息技术及产品供给和应用，构建通用性强、

软硬协同的数智技术底座，形成一批行业电子系统集成和解决方案，支持电子信息制造业数字化转型促进中心及推进中心建设，推动典型场景率先突破和规模化应用，带动各行业生产运营、管理服务全链条数字化改造与智能化升级。面向智慧城市、智慧农业、智能驾驶、智慧医疗、低空经济、商业航天、深海极地等现实需求，研发针对特定领域应用的电子信息产品，推动电子技术和行业应用深度融合，以场景应用牵引行业电子高端化、专业化发展。

专栏 9 行业电子创新发展
1.城市感知。围绕城市生命线安全工程、公共空间等城市治理重点领域，研发先进泛在智能感知终端、5G 轻量化（5G RedCap）通信设备。 2.汽车电子。主攻车载智能计算平台、电子电气架构、车规级元器件及车联网通信技术，开发高安全自动驾驶控制系统、智能座舱系统及车路协同终端产品。 3.医疗电子。主攻高端诊疗设备专用芯片、传感器、智能便携监测终端等，突破生物传感、人机交互、精准成像等瓶颈，提升高端影像设备、体外诊断仪器、可穿戴健康监测等产品软硬一体化供给能力。 4.航空电子。支持航电系统集成、高可靠传感器、处理器及编码器、通信导航设备、计算及自动化等技术及产品攻关，推动航空电子产品在空管系统、民用航空、通用航空及无人机等领域应用。 5.航天电子。突破抗辐照芯片及器件、星间激光通信、星载计算平台、高精度导航等核心技术，加快构建智能化、模块化、通用化航天电子产品体系，重点支撑太空计算等新兴产业发展。 6.海洋电子。重点突破海洋环境智能感知、水下高精度通信导航、海洋无人系统智能化等关键技术，研发适配深远海作业、极地作业的探测装备、资源开发利用装备、观测终端、数据传输系统与计算设备。

（四）增强产业可持续发展能力

14.全面提升自主创新能力。加强电子信息领域高价值专利布局，靠前储备关键核心技术领域专利，建立集成电路、

北斗、光伏、新型电池等重点领域专利池，促进知识产权交叉许可和共享，提升涉外知识产权服务能力。持续完善电子信息制造业标准体系，加快重点标准制修订及实施，加强国家标准、行业标准协同，推进军民标准通用化。凝聚各类主体特色专长，分层级培育电子信息领域国家战略科技力量，支持有条件的企业和科研院所布局一批全球创新载体。提高“芯火”平台、电子信息领域制造业创新中心、国家产业技术工程化中心等平台创新能级，聚焦重点领域建成一批电子信息制造业概念验证平台、中试平台和孵化器。

15.提升产业治理现代化能力。及时开展行业规范条件制修订。统筹推进细分行业产能规划布局和产能预警，综合整治“内卷式”竞争。开展产业安全能力建设，强化网络安全防护，加强锂电池等领域安全生产管理，提升本质安全水平。深入实施制造业卓越质量提升工程，开展企业质量管理能力评价。加快发展服务型制造，开展定制化服务、检验检测、信息增值服务等模式应用，延伸服务链条。建立规范的终端产品快速充电技术和标准体系，加快推动电视操作复杂治理。推动电子信息绿色低碳转型，加快电子信息产品碳足迹核算规则标准供给，构建电子信息产品碳足迹数据库。加强锂电池、光伏组件报废退役管理，提升废弃电子产品高值化规范化利用水平，支持精细化拆解、数据擦除和综合利用等关键共性技术研发应用。

16.优化产业区域协同布局。强化产业集聚，打造电子信

息区域协同发展体系，培育电子信息领域世界级先进制造业集群。支持重点区域建设电子信息综合发展集聚区，推动创新链、产业链、资金链、人才链高效融通发展。围绕重点领域支持若干区域和重点省份建设一批专业化特色产业集聚区，探索电子信息新技术新模式新应用。支持国家高新区围绕电子信息培育布局一批新赛道，推动产业协同创新网络建设，强化跨区域园区间产业协作。加快电子信息重点领域国内产业有序转移，强化中西部地区承接能力。支持各地推进电子信息领域工业文化建设，打造一批电子信息博物馆、工业遗产。

17.构建对外开放合作新格局。统筹国内国际两个市场、两种资源，发挥双多边国际交流合作机制作用，巩固中间品贸易规模，扩大高端产品出口，支持重点领域举办国际交流活动，提升中国电子信息品牌国际影响力。积极参与国际标准化活动，推动更多中国标准走向国际。推动电子信息制造业配套检测认证服务业提升国际化经营水平。提升电子信息重点领域遏制打压风险研判和应对能力，完善电子信息制造业反制裁、反长臂管辖相关措施。

三、加强组织实施

坚持党的全面领导，加强政策统筹协调，充分发挥电子信息领域协调机制作用，完善部门协同、央地联动的组织体系。加大资源保障力度，充分利用现有资金渠道实施重大战略任务。一体推进教育科技人才发展，加强电子信息人才支

持保障，加强产业人才需求预测，促进产教融合发展，加快海外人才引进。强化电子信息产融深度合作，引导金融机构加强对电子信息制造业健康发展的金融支持，鼓励金融租赁公司提供特色化金融服务。大力开展政策宣贯，工业和信息化部会同有关部门开展规划实施监测与评估。充分发挥行业协会商会优势和作用，强化行业自律、供需对接与服务赋能。